

株式会社 アルバック

2020 年度第 3 四半期 決算説明カンファレンスコール（2021 年 5 月 14 日開催） およびアナリストミーティングの主な質疑応答（サマリー）

【通期予想】

① **通期業績予想の上方修正について、当初売上計画 1,650 億円から 1,800 億円に 150 億円売上が増加した割には営業利益率がそれほど上回っていないのはなぜか？**

A: 通期の売上総利益率は、前年度の 27.3%を 2P 程度上回る見込み。当初の計画 31.2%と比べると改善に時間がかかっているが、モノづくり改革による利益率改善への取組は着実に進んでおり、成果に結びついている。今後も着実に改善を図っていきたいと考えている。

② **下期の営業利益率は上期 7.0%から 11.1%に改善する見込みだが、売上総利益率は上期 27.8%からどの程度になる見込みか？また改善理由について、①利益率改善効果、②ミックス改善効果、③売上減少のマイナス効果に分けて説明してほしい。**

A: 下期の売上総利益率は上期 27.8%に対して 2P 強増加する見込み。①売上高が 838 億円から 962 億円に増加することによる利益率改善効果が大きく、次いで、②利益率改善効果、③半導体・電子の売上高に占める割合が 27%から 3 割台半ば程度に上がるミックス改善効果の順となっている。

③ **3Q の FPD および半導体電子部品の受注高・売上高の用途別内訳は？**

A: 別紙 1 の通り。

④ **3Q の営業利益率の品目別の順位は？**

A: 別紙 1 の通り。

⑤ **年間予想の FPD および半導体電子部品の受注高・売上高の用途別内訳は？**

A: 別紙 2 の通り。

【半導体電子】

⑥ **半導体装置の事業環境について、今年に入って半導体メーカーの設備投資計画が上方修正されている中、足元の受注増加状況と来期以降の見込みについて教えてほしい。**

A: 半導体はメモリもロジックも通期で前年比 3 割程度受注が増加すると見込んでいる。半導体・電子の通期修正受注見込み 600 億円のうち約 250 億円が半導体関連の受注となる見込みで、当初計画比 2 割程度の受注増加となる見込み。

前年比・当初計画比で増加した主な要因はメモリの伸び。

下期の半導体の受注額は、DRAM・NAND の投資活発化により、上期比約 4 割増加する見込み。

来年度計画については、8 月の通期決算開示時に説明する予定だが、足元の状況からすると、NAND・DRAM は今年度から更に 3 割程度伸びるのではないかと見ている。

ロジックのメタルハードマスク工程は、微細先端デバイス世代の拡大に伴い、来年度から再来年度にかけて大きく伸びることを見込んでいる。また、ロジックのメタルハードマスク工程以外の工程にもチャレンジしており、ロジック全体として3割を超える伸びを目指していくことになると思う。

半導体全体でも、来年度は今年度比3割を超える受注増加を計画していくことになるのではないかと見ているが、具体的な数値等は8月に説明する。

⑦ **PCRAM の受注は来期以降どのように伸びていくのか？米国のメモリーメーカーが撤退し工場を売却すると発表したが、米国のロジックメーカーは続けるのか？他社の動向は？来年度はどの程度見込んでいるのか？**

A: 米国のメモリーメーカーの工場売却発表については、売却先等が分からないのでその影響についてお話しできることはない。米国ロジックメーカーは、昨年末以降、PCRAM を顧客ごとにカスタマイズした提案を行い好評であることをHP等で積極的に説明しており、市場開拓を着々と進めていると理解している。投資時期はまだはっきりとわからないが、中期経営計画期間中に相応の投資が期待できるのではないかと考えている。

なお、PCRAMを見込まずとも、半導体関連の来期受注は今年度比3割程度増加するのではないかと現段階では考えている。

他の半導体メーカーの動向としては、基本的には各メモリーメーカーの持つDRAM・NANDと競合する面もあり、市場が先行メーカー製品を受け入れた場合にすぐに量産対応できるよう、量産開発をそれぞれが進めており、その各社ともに当社のスパッタリング装置を導入している。

⑧ **半導体・電子の受注高は、3Q 累計実績・通期予想ともに前年同期を上回っているが、電子部品関連の伸びはどの程度か？分野別にみると何が伸びているのか？**

A: 電子部品関連の3Q 累計実績は前年同期比約1割増加、通期予想では約4割弱の増加となる見込み。パワーデバイスが前年比2割伸びており、日本ではIGBT向けを中心に、中国ではSiC向けを中心に伸びている。またSAW・BAW フィルター向け通信デバイス、μOLED・車載AR膜・3Dセンサー向けオプトデバイスが前年比・計画比ともに伸びている。地域別では日本、中国市場ともに伸びている。

⑨ **半導体・電子のQ毎の受注を見ると、2Q前倒し受注の影響で3Qが一旦低下し、4Qが大幅増となる見込みのようだが、4Qは何が伸びるのか？**

A: 上期決算説明時に説明した通り、2Qは3Qに予定していた電子（オプトデバイス）関連の約30億円の受注が前倒しとなり、大きく伸びた。仮に前倒しの30億円を予定通り3Qに受注していれば、2Q160億円、3Q150億円程度の受注となっていた。4Qも引き続き、電子関連では、日本・中国を中心にパワーデバイス、SAW フィルター向け等の通信デバイス、車載AR膜等の受注が増加、半導体関連ではメモリー関連が増加すると見込んでいる。

⑩ **電子関連は来年度どのように伸びると考えているのか？**

A: 引き続きパワーデバイス、オプトデバイス、通信デバイス等を中心に投資が継続すると考えており、さらに成長していくと考えている。

【FPD】

- ⑪ **業績予想の修正で受注高の内訳をみると、FPD・PV は当初計画の 470 億円から 415 億円に減少する見込みとなっているが、なぜ減少するのか？ スマートフォン用 OLED 蒸着 2 ラインはいつ受注予定なのか？**

A: 期初に計画策定した際は、上期に大型 TV 用 LCD のまとまった追加投資と下期のスマートフォン用 OLED の蒸着 2 ラインを中心に受注を見込んでいた。今回、OLED 蒸着 2 ラインの受注が来期にずれの可能性があることから今期の受注予想を減額修正している。

一方、新型コロナウイルスによる巣ごもり需要等により、タブレットや PC など IT 用や大型 TV 用の LCD 投資案件が増加した（60 億円程度増加）。また、スマートフォン用 OLED のバックプレーン用スパッタ装置の受注について競合との関係で堅めに見ていたが、高精細化のためにパーティクル（微細なゴミ）が少ないことで評価が高まり受注となった（約 50 億円）ことなどから、OLED 蒸着装置の来期への期ずれの可能性を見込んで 415 億円の受注予想となった。

蒸着装置 2 ラインは、今期中に受注になる可能性も残っているが、現段階では来上期の受注を見込んでいる。

- ⑫ **FPD の受注は当初計画比減額予想となっているが、来期に向けた LCD・OLED の投資環境をどのように考えているのか？ 来期の受注高・売上高はどの程度になると考えたいのか？**

A: 巣ごもり需要に対応したタブレットや PC など IT 用の LCD パネル投資の来年度も継続に加えて、大型 TV 用の LCD 追加投資も見込まれ、LCD 関連の投資は今年度以上となる可能性もあると考えている。

スマートフォン用 OLED 投資も、各社が継続的に投資を予定しており、バックプレーン用のスパッタ装置等の受注も見込めると考えている。蒸着装置については、来期に期ずれした場合、2 ラインを見込むことになると考えている。また、大型基板の OLED についても量産開発が進められており、来期以降、ビジネスチャンスが広がると考えている。

8 月に来期の計画を説明するので、現段階では具体的な数値を申し上げることはできないが、蒸着装置 2 ライン分が来期に期ずれした場合、今期を大きく上回る受注となるのではないかと考えている。

【その他】

- ⑬ **緊急事態宣言が延長になったが、新型コロナウイルスのビジネスへの影響はどうか？**

A: 半導体・電子・FPD 等は、巣ごもり需要で世界的に IT 用や大型 TV 用のパネル需要が増加し、半導体も不足感が高まるなど、顧客企業の投資姿勢は高まってきており、特に緊急事態宣言延長でビジネスに大きなマイナスの影響は見られない。移動の制約等はあるが、現場支援や商談のリモート対応等により補う体制もできてきている。

- ⑭ **半導体関連の投資が活発化しており、製造装置メーカーの部材調達等で納期の長期化等が見られるとの話も聞かすが、アルバックも調達はタイト化しているか？ どのような対策を取っているのか？**

A: 半導体関連の設備投資需要増加に加え、米国テキサスの寒波・停電等の影響もあり、各種素材の材料不足なども重なり、長納期化しているものもある。

取引先メーカーのリードタイムを確認しながら、必要に応じて前倒し発注を行うなどの対応を行っている。今のところは生産への大きな影響は出ていないが、確りと対応していきたいと考えている。

〈別紙1〉

品目別実績 内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2020 3Q
半導体電子（億円）	121
・メモリ	4割強
・ロジック	1割強
・電子部品	2割弱
・パワー半導体	1割強
・実装	1割半ば
FPD（億円）	83
・LCD	5割半ば
（大型向け割合）	（大型向け6割強）
・OLED	2割強
・その他	2割強

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2020 3Q
半導体電子（億円）	162
・メモリ	4割弱
・ロジック	1割弱
・電子部品	約3割
・パワー半導体	2割弱
・実装	1割弱
FPD（億円）	103
・LCD	3割弱
（大型向け割合）	（大型向け6割半ば）
・OLED	約6割
・その他	1割強

●営業利益率順位 2020年度3Q実績

順位	品目
1	半導体電子
2	コンポーネント
3	その他
4	材料
5	FPD
6	一般産業

全社平均利益率は
2) コンポーネントと
3) その他 との間

〈別紙2〉

品目別予想 内訳割合

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2020 年間予想
半導体電子（億円）	600
・メモリ	3割強
・ロジック	1割弱
・電子部品	3割強
・パワー半導体	2割弱
・実装	1割弱
FPD（億円）	415
・LCD	5割半ば
（大型向け割合）	（大型向け7割半ば）
・OLED	3割半ば
・その他	約1割

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2020 年間予想
半導体電子（億円）	565
・メモリ	3割半ば
・ロジック	1割弱
・電子部品	3割強
・パワー半導体	2割弱
・実装	1割弱
FPD（億円）	450
・LCD	3割半ば
（大型向け割合）	（大型向け8割強）
・OLED	約5割
・その他	1割半ば